



報道関係各位

プレスリリース

EV Group、量産向け次世代レジストプロセス装置「EVG®120」を発表

超小型・新プラットフォームにより、よりコンパクトで柔軟な構成に、
in-situ レジスト厚さ計測とウェーハエッジ露光機能を搭載。上位機種 EVG®150 の高性能を実現

オーストリア ザンクト・フローリアン、2026年2月18日—最先端および将来の半導体設計と半導体集積化スキームを支える革新的なプロセスソリューションと専門知識を提供するリーディングプロバイダーであるEV Group（以下、EVG）は、本日、次世代の自動レジストプロセス装置 EVG®120 を発表しました。本製品は、同社の主力コータ/デベロッパープラットフォームを大幅に刷新するものです。すでに多くのお客様に広く採用されている EVG®150 システムから受け継がれたコンパクトな新アーキテクチャ、画期的な機能、そして設計改良を取り入れた新型 EVG120 は、前世代機と比較して大幅に高いスループット、優れた柔軟性、そして改善されたプロセス制御を実現しました。これらすべてを、最大限の柔軟性が求められる多様な製品とレジストプロセスを扱うお客様向けに最適化された、よりコンパクトなフットプリントで提供します。



次世代の自動レジストプロセス装置 EVG®120

次世代 EVG120 は、先端パッケージング、MEMS、イメージセンサー、フォトニクス、パワーデバイス、ウェーハプロープカードなど、急成長を遂げているアプリケーション分野に最適な装置です。フォトリソグラフィで使用されるフォトレジスト材料のスピンドルコーティング、スプレーコーティング、現像に適応します。幅広い基板タイプとサイズ（2インチから 200mm まで）に対応し、薄型、厚型、ポジ型、ネガ型、PI や PBO などの誘電体材料、特殊用途向けの黒色/カラー/IR レジストなど、多様なレジスト材料に柔軟に対応します。

来週（2月 22 ~ 26 日）カリフォルニア州サンノゼで開催される SPIE Advanced Lithography and Patterning (SPIE-AL+P) カンファレンスで、次世代の EVG120 プラットフォームおよびその他の革新的なリソグラフィプロセスソリューションについて EVG のエグゼクティブによる説明が行われます。



新プラットフォーム、拡張された機能

EVG120 は、最大 2 つのウェットプロセスモジュールと 14 枚のベーク/冷却プレートを統合したコンパクトな 200mm プラットフォームをベースに再設計され、前世代のプラットフォームと比較して処理能力が 40% 向上しました。システムの設置面積も 20% 以上削減され、設計の改良により装置メンテナンスが容易になり、柔軟なモジュール構成も実現しました。

このシステムには、前世代にはなかった複数の新機能も搭載されています。

- **ウェーハエッジ露光 (WEE)** – 選択的なエッジ露光により、エッジ精度と均一性が向上
- **In-situ レジスト膜厚測定** – リアルタイムのプロセスモニタリングにより、歩留まりとプロセス制御が向上 (測定範囲: 50 nm~50 ミクロン)。
- **新たに最適化された高粘度ディスペンスシステム** – クローズドループフィードバックによる高圧ディスペンシングにより、厚膜フォトレジストへの高精度コーティングを実現
- **SMIF ロードポートのサポート** – よりクリーンで効率的な材料処理を実現
- **スタンバイモード** – アイドル時の消費電力を削減し、SEMI E167 に準拠

これらの新機能は、CoverSpin™ ボウル設計や OmniSpray® コンフォーマルスプレー コーティング技術など、EVG の実績あるコーティング技術を基盤としています。CoverSpin™ は優れた均一性と材料消費量の削減に寄与し、OmniSpray® は複雑な凹凸構造や繊細な基板に対して最適なコーティングを提供します。

EV Group のコーポレート・テクノロジー・ディレクター、トーマス・グリンスナー博士は次のように述べています。「次世代の EVG120 プラットフォームは、EV Group のフォトレジストおよびリソグラフィプロセスにおける数十年にわたる経験を結集し、研究開発から量産まで、多様化が進むお客様のニーズへの対応を可能にします。in-situ レジスト厚さ計測やウェーハエッジ露光といった新機能に加え、EVG150 プラットフォームから継承した機能を備えた EVG120 は、コンパクトな量産対応プラットフォームでありながら、コーティング・現像性能、スループット、柔軟性、そして所有コストの全てにおいて、他に類を見ない価値を提供します。」

製品のご購入について

EVG は現在、次世代システム EVG120 の受注を開始しており、EVG オーストリア本社にて製品のデモンストレーションも承っております。詳細は、<https://www.evgroup.com/ja/products/lithography/resist-processing-systems/evg120> をご覧ください。

EV Group (EVG)について

EV Group (EVG) は、最先端、かつ将来の半導体設計と半導体集積化スキームに役立つ革新的なプロセスソリューションと専門知識を提供しています。「革新技术の探求、そして、マイクロ・ナノ加工技術の次世代アプリケーションを提供する先駆者であり続ける」というビジョンのもと、独自の技術を駆使して、お客様の新規製品開発と商品化をサポートしています。ウェーハ接合、リソグラフィ、薄ウェーハ処理、計測機器などの EVG の量産対応製品は、半導体製造前工程におけるスケーリング、3D 集積、先端パッケージング、その他のエレクトロニクスやフォトニクス・アプリケーションの進歩を可能にします。EVG に関する詳しい情報は <https://www.evgroup.com/ja/> をご参照ください。



お問い合わせ先:

イーヴィグループジャパン株式会社 マーケティング担当

TEL: 045-348-0665

E-mail: Marketing+CommunicationsJapan@EVGroup.com

Contacts:

Clemens Schütte
Director, Marketing and Communications
EV Group
Tel: +43 7712 5311 0
E-mail: Marketing@EVGroup.com

David Moreno
Principal
Open Sky Communications
Tel: +1.415.519.3915
E-mail: dmoreno@openskypr.com

<報道関係者からのお問い合わせ>

オフィス KNN (EV Group 広報代理)

担当: 牧平、中山

Email: info@officeknn.com

TEL: 080-3062-2406/080-5006-1392